

吉安满坤科技股份有限公司

2026 年 9 月 14 日-9 月 17 日投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	招商电子 博时基金 鹏华基金 长城基金 聚鸣投资 信达澳亚 摩根士丹利基金 浦银安盛 银华基金 华金证券 上海昱奕资产 前海人寿 光影资本 匀丰资产等
时间	2026 年 9 月 14 日-2026 年 9 月 17 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：洪耿奇先生 风控中心副总经理：洪丽冰女士 董事会秘书、财务总监：耿久艳女士 投资总监：陈鹏飞先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司整体情况 简要介绍了公司发展历程、业务结构、主要产品、应用领域、核心竞争力及行业未来的趋势等。 二、回答投资者提问 1、请介绍公司在泰国投资项目的进展情况？ 答：公司基于业务发展及海外生产基地布局需要，为进一步拓展海外市场，满足客户需求，在泰国投资建设新的生产基地，公司已在董事会的授权范围内顺利完成泰国公司的设立登记、国内备案登记、土地协议签署、增资、土地地契过户等事宜，且顺利收到泰国投资促进委员会（BOI）颁发的《投资优

	惠证书》，并正在逐步推进泰国工厂的基建工作和针对此工厂的升级及加大建设计划，泰国工厂预计于 2027 年开始陆续投产，具体以实际建设投产时间为准。公司泰国工厂的逐步建设将满足 AI 服务器电源高多层板等客户需求，完善公司海外生产基地的布局，增强公司核心竞争力。 2、请介绍公司发行可转债的进展情况？ 答：公司已于 2026 年 7 月 20 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1757 号）。公司及保荐机构积极安排发行前的各项准备工作，将结合市场情况及监管要求择机安排发行。本次可转换公司债券事项后续发行时间及发行结果均存在不确定性，公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。 3、请介绍本次可转债发行的投向，以及对公司的影响？ 答：本次发行可转换公司债券的募集资金拟用于投入“泰国高端印制电路板生产基地项目”和“智能化与数字化升级改造项目”。 关于“泰国高端印制电路板生产基地项目”：公司拟于泰国投资建设高端印制电路板生产基地，旨在顺应行业发展趋势，优化公司产能布局，匹配 AI 服务器电源高多层板等领域客户的本地化产能诉求，快速响应相关客户的订单需求，进一步强化客户合作黏性，同时挖掘海外市场业绩新增量，提升公司在全球市场的竞争力。 关于“智能化与数字化升级改造项目”：公司通过本项目拟引进高自动化、高精度的智能化生产设备及数字化管理系统，对公司现有生产基地实施智能化升级改造，通过在关键工序增设智能化设备，提升关键工序精度与设备处理能力，进而升级产品结构、提升产品质量，以全面提升生产运营效率与产品精度管控水平；同时搭建数字化信息系统、强化信息安全建
--	---

	设，为公司 PCB 产品规模化量产提供关键智能制造支撑，助力公司扩大市场份额、强化核心竞争力。 4、公司在 AI 服务器电源方面业务的拓展情况如何？ 答：受益于 AI 算力需求爆发式增长，AI 服务器电源（AC/DC）作为电源组件市场的核心增量赛道，展现出强劲成长趋势。AI 算力硬件 PCB 订单需求旺盛，公司近年来深耕 AI 服务器电源高多层板领域，业务持续放量，目前已实现 3300W、4200W 及 5500W 等规格电源高多层 PCB 产品的量产与稳定交付，泰国工厂达产也将进一步支撑公司订单承接。公司将积极把握 AI 产业发展机遇，持续深入挖掘头部客户产品需求，不断拓展中高端 AI 服务器电源 PCB 订单。 5、公司在汽车电子领域的业务情况如何？ 答：汽车电子是公司市场战略布局的重点领域，属于公司核心基本盘之一。公司聚焦车载高附加值核心硬件领域，打造了覆盖整车动力控制、毫米波雷达、充配电系统、BMS、车身电子控制、整车热管理、智能座舱、通信及网联系统及高阶智能驾驶（ADAS）域控制器等全场景高端 PCB 产品矩阵。公司三阶 HDI 车载域控板已获取重要定点项目，将不断夯实车载高端 PCB 的技术卡位，深入拓展高端价值业务领域。凭借核心技术优势、成熟的品控体系与规模化交付能力，公司与国内外头部汽车电子 Tier1 的优质客户保持长期稳定的合作关系，公司将持续获取新项目订单，加速车载高阶 HDI 产品规模化，持续开拓汽车电子领域的市场份额。 6、三季度净利润多少？ 答：关于具体业绩情况，请关注公司后续披露的相关定期报告。 本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 9 月 17 日